

平安证券股份有限公司

关于上海伟测半导体科技股份有限公司

2024 年年度持续督导跟踪报告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“伟测科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，于 2024 年 7 月承接伟测科技首次公开发行股票持续督导工作，并出具 2024 年年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与伟测科技签订保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	本持续督导期间，伟测科技未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	本持续督导期间，伟测科技在持续督导期间未发生重大违法违规或违背承诺等事项。
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构承接持续督导工作之后，与伟测科技保持密切的日常沟通，通过定期或不定期回访、现场检查等方式持续关注伟测科技生产经营、信息披露情况，对伟测科技开展持续督导工作。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	保荐机构承接持续督导工作之后，督导伟测科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所

序号	工作内容	实施情况
		易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构承接持续督导工作之后，督促伟测科技依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对伟测科技的内部控制制度的设计、实施和有效性进行了核查，伟测科技的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构承接持续督导工作之后，督促伟测科技严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对伟测科技的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	本持续督导期间，伟测科技及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，伟测科技及其实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，经保荐机构核查，伟测科技未出现该等事项
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法	本持续督导期间，伟测科技未发生相关情况。

序号	工作内容	实施情况
	违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	
15	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量。上市公司出现下列情形之一的,保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查:（一）存在重大财务造假嫌疑;（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益;（三）可能存在重大违规担保;（四）资金往来或者现金流存在重大异常;（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	保荐人已制定了对伟测科技的现场检查工作计划,并明确了现场检查工作要求,确保现场检查工作质量。本持续督导期间,伟测科技不存在需要专项现场检查的情形。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

保荐机构于 2024 年 7 月承接伟测科技首次公开发行股票的持续督导工作。2024 年度,保荐机构和保荐代表人未发现伟测科技存在需要整改的重大问题。

三、重点风险事项

2024 年度（以下简称“报告期”），公司主要的风险因素事项如下：

（一）经营风险

1、进口设备依赖的风险

公司产能持续扩张，固定资产投资规模持续增长。公司现有机器设备以进口设备为主，主要供应商包括 Advantest（爱德万）、Teradyne（泰瑞达）、Semics 等国际知名测试设备厂商。公司进口设备主要是测试机、探针台、分选机及相关配件，是公司测试业务的关键设备。截至目前，公司现有进口设备及募集资金投资项目所需进口设备未受到管制。若未来国际贸易摩擦加剧，从而使本公司所需的测试设备出现进口受限的情形，将对本公司生产经营产生不利影响。

2、公司发展需要投入大量资金的风险

集成电路测试行业属于资本密集型行业，产能规模是集成电路测试企业核心竞争力的直观体现，随着公司原有客户对公司的测试需求不断提升，以及公司不断开拓新客户、开发新的测试服务，公司需要继续增加测试产能，对公司的业绩

起到支撑和提升的作用。因此，公司对采购测试机、分选机、探针台等测试设备的需求也不断提升。同时，集成电路测试行业具有“大者恒大”的客观规律，规模越大的集成电路测试企业在行业内相对更易获得客户订单、赢得客户信任，具有与客户进行长期合作的规模基础。若公司未来融资渠道、融资规模受限，导致发展资金短缺，可能对公司的持续发展和市场地位造成不利影响。

（二）技术风险

1、技术更新不及时与研发失败风险

随着集成电路行业自身的发展以及下游产品更新迭代的速度加快，高性能、多功能的复杂 SoC 以及各类先进架构和先进封装芯片（Chiplet、Sip 等）渐成主流，公司研发的测试方案需要不断满足高端芯片对测试的有效性、可靠性、稳定性以及经济性的需求，研发难度大大增加。此外，客户的测试需求也在不断变化，各类定制化要求层出不穷，公司要随之更新测试技术以适应市场的变化。如果公司未能在技术研发上持续投入，未能吸引和培养更加优秀的技术人才，可能存在研发的测试方案或开发的测试技术不能达到新型芯片产品的测试指标，导致研发失败的风险，进而对公司的经营造成不利影响。

2、研发与技术人才短缺或流失的风险

集成电路测试行业属于技术密集型产业，测试方案开发、测试量产都依赖于理论知识和工程经验丰富的技术人员。目前，相对于广阔的市场空间，专业测试研发技术人员仍相对匮乏。此外，同行业竞争对手可能通过更优厚的待遇吸引公司技术人才，同时，公司可能会受其他因素影响导致技术人才流失。上述情况将对公司测试方案的研发以及测试技术能力、测试技术人才的储备造成不利影响，进而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

（三）财务风险

1、主营业务毛利率下降的风险

公司主营业务毛利率与产能利用率、测试设备折旧、人力成本、市场供需关系等经营层面变化直接相关。同时，由于公司测试平台及配置种类较多，不同平台和配置的单价及成本差异较大，因此平台和配置的结构变化也会对公司主营

业务毛利产生较大影响。若未来上述因素发生不利变化比如产能利用率下降、设备折旧增加、人力成本上升或市场需求萎缩导致服务价格下降、成本上升，则公司主营业务毛利率可能出现下降的风险。

（四）行业风险

1、行业竞争加剧的风险

随着集成电路测试需求的不断扩大，独立第三方测试企业和封测一体化企业等各类测试服务商继续扩大产能、增加投入，市场竞争变得日趋激烈。若公司未来无法缩小与封测一体化企业和独立第三方测试头部企业之间的差距，将有可能在竞争中处于不利地位。

2、行业周期波动的风险

2022 年下半年至 2024 年初，集成电路行业进入了新一轮的下行周期，公司净利润整体呈现下降趋势，但是从 2024 年 6 月开始，该趋势已经发生扭转，但如果未来集成电路下游行业景气度降低、市场需求不及预期，下游客户业绩增长疲软，则可能对公司业绩造成不利影响。

四、重大违规事项

2024 年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024 年度，公司主要财务数据如下表所示：

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2024年	2023年	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	1,076,869,868.17	736,524,835.36	46.21
归属于上市公司股东的净利润	128,228,784.44	117,996,286.47	8.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,811,223.74	90,678,572.15	18.89
经营活动产生的现金流量净额	621,805,601.66	462,549,416.97	34.43

主要会计数据	2024年末	2023年末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,619,076,189.03	2,458,667,718.78	6.52
总资产	4,919,016,975.28	3,608,104,998.73	36.33

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本报告期比上年同期 增减 (%)
基本每股收益（元 / 股）	1.13	1.04	8.65
稀释每股收益（元 / 股）	1.13	1.04	8.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元 / 股）	0.95	0.80	18.75
加权平均净资产收益率（%）	5.06	4.89	增加 0.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	4.25	3.76	增加 0.49 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	13.22	14.09	减少 0.87 个百分点

（三）主要会计数据和财务指标的变动说明

2024 年，公司实现营业收入 107,686.99 万元，较上年同期增长 46.21%，主要系本报告期行业景气度提升、测试产品结构优化、新客户量产、产能利用率不断提高所致。

2024 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 12,822.88 万元，较上期增加 1,023.25 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,781.12 万元，较上期增加 1,713.27 万元。虽营业收入增长使得公司贡献毛利额增加，但因股权激励确认的股份支付费用、研发投入和因产能扩张导致折旧、摊销、人工费用等成本费用同比增长致使净利润增长幅度小于营收增长幅度。

2024 年和 2023 年公司因股权激励确认的股份支付费用分别为 5,472.55 万元和 3,464.35 万元，如果剔除股份支付的影响,2024 年归属于上市公司股东的净利润为 1.83 亿元,较上期增加 19.86%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 491,901.70 万元，同比增长 36.33%；归属于上市公司股东的净资产 261,907.62 万元，同比增长 6.52%，主要系报告期内公司积极推进募投项目，扩大测试产能购买相关设备和新建厂房所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）核心竞争力分析

1、人才优势

公司核心团队在集成电路行业深耕细作二十余年，团队成员先后在摩托罗拉、日月光、长电科技等业内知名半导体企业从事研发、生产和管理工作，积累了极其丰富的行业经验，对于行业的发展趋势和市场需求的判断存在着自身独到的见解。在集成电路测试方面，公司核心团队对测试技术包括测试方案的开发、测试车间 IT 自动化管理及调试、提高测试生产效率、提升量产规模等方面有着丰富的经验。报告期内，公司继续加强研发人员的培养和引进，截至报告期末，公司研发人员共计 458 人，占公司员工总数的比重为 23.94%，强大的研发团队保障了公司在核心技术方面的领先地位。

2、技术优势

公司的技术优势主要体现在测试技术水平领先、测试方案开发能力强及生产自动化程度高三个方面。小 Pad 间距以及芯片成品测试的封装尺寸大小、测试频率等参数上在国内处于领先水平，并与国际巨头持平或者接近。

在测试方案开发能力方面，公司突破了先进制程芯片、5G 射频芯片、高性能 CPU 芯片、FPGA 芯片、复杂 SoC 芯片等各类高端芯片的测试工艺难点，同时，高算力高性能芯片、车规及工业级高可靠性芯片的测试研发是公司重点的研发方向，公司进一步加大相关研发投入的力度，目前公司具备相关的测试能力，获得了客户的信任。公司积极开发各类高端芯片测试方案，在一定程度上成功实现了国产化替代。

在生产自动化程度方面，公司对标国际巨头，通过将测试作业中积累的技术和经验融入 IT 信息系统，自主开发了符合行业特点的生产管理系统，提升了测试作业的信息化、自动化、智能化水平，提高了测试作业的准确率和效率。

3、客户优势

公司的客户包括了集成电路设计公司、晶圆制造企业、IDM 企业和封装企业，公司营业收入中占比较大的客户为集成电路设计公司，公司客户超过 200 家，其中高端芯片设计公司出于对其自身测试服务需求的把控、成本控制以及风

险控制，将为其提供测试业务供应商的选择由境外转向境内。

2024 年公司继续扩充测试产能、加大研发投入、加强与客户交流，根据客户发展情况制定不同种类高端芯片的研发，根据客户的测试需求积极安排相应测试机台为客户提供服务，获得了行业内客户的高度认可。

4、测试设备规模及测试产能优势

集成电路测试行业具有“大者恒大”的客观规律，除了备受重视的研发投入规模以外，测试产能规模是集成电路测试企业的核心竞争力之一。充足的产能规模能够吸引客户的重视，是接受行业内高端测试客户订单的必要条件。足够的测试产能还能让公司在行业处于相对上行的周期时快速响应客户的测试需求，在行业处于相对下行的周期时保证一定的生产规模，从一定程度上抵消行业波动对经营产生的不良影响。此外，目前国内大部分测试厂商定位中低端市场，在复杂和高端产品的测试能力上相对欠缺，故高端测试产能相对紧缺；而进行高端测试需使用高端测试设备，这些设备采购价格较高，交付周期相对较长，且相关设备的研发及生产长期被海外巨头垄断，每年供给的数量相对有限。

与同行业公司相比，公司十分重视产能规模尤其是高端测试产能的建设。基于公司自身战略规划考量、兼顾不同客户的不同测试需求、集成电路行业新产品和终端应用对产品的需求和要求，以及对行业整体发展的认知，2024 年公司稳步实施扩产计划，继续购入爱德万 V93000、泰瑞达 UltraFlex Plus、泰瑞达 UltraFlex 等高端测试相关设备。截至 2024 年年末，公司的产能规模，尤其是高端测试产能规模在中国大陆独立第三方测试企业中处于相对优势水平，高端测试设备数量在中国大陆行业领先。在此基础上，公司进一步夯实了公司在中国大陆独立第三方测试企业中的行业领先地位。

5、区位优势

2024 年度，公司拥有上海、南京、无锡和深圳四个测试基地。公司以长三角市场和珠三角市场为双引擎，连接全球半导体产业链（设计、制造、设备），覆盖中高端制造集群，贴近终端客户，有利于快速响应客户对晶圆测试及芯片成品测试的需求、有利于降低芯片运输损耗与时间成本，有利于灵活调配产能与缩

短供应链周期。同时，长三角和珠三角人才储备充足、高校资源丰富，公司在人才招聘上有着巨大优势。最后，长三角和珠三角各地区在产业政策和招商引资上也存在着丰富的优势。

（二）核心竞争力的变化情况

2024 年度，伟测科技的持续竞争力未发生重大不利变化。

七、研发支出及变化情况

（一）研发支出情况

2024 年度公司研发费用达 14,237.79 万元，较上年同期增长 37.16%，主要原因如下：（1）因部分研发人员被授予限制性股票，研发费用中股份支付金额 2,440.57 万元；（2）集成电路测试行业具有技术密集型的特点，为了增强公司的技术竞争力以及贯彻公司的“高端化战略”，公司研发中心在测试工艺难点的突破和测试方案的开发、各类基础性的测试技术的研发、测试硬件的升级和改进、自动化生产和智能化生产 IT 系统的研发等方面投入了大量的人力物力。

（二）研发进展

1、报告期内研发成果

2024 年度，公司研发工作有序推进，公司新获得发明专利 2 项、实用新型专利 7 项、软件著作权 23 项。截至 2024 年末，公司累计获发明专利 16 项、实用新型专利 86 项、软件著作权 74 项。

2、在研项目情况

2024 年度，公司在研项目情况如下：

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标
1	成品芯片测试智能化管理	已结项	设备备件防呆和保护，降低备件损坏率，以达到企业降本增效的目的。
2	车规测距芯片的测试技术的降本增效开发	已结项	本项目计划通过参考车规测距芯片的参数性能和数据处理方法，进行升级同类芯片测试，提高测试效率，缩短测试时间，从而达到车规测距芯片的测试降低成本的目的。

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标
3	基于 93K 及 J750 平台的测试方案开发（四期）	已结项	利用 93K 及 J750 平台实现公司在 CPU、GPU、MCU 等高性能集成电路测试方案的研发；对高效测试、高覆盖率测试提出全新的测试方法；对未来新的测试技术和测试方案进行提前布局和预研，以满足未来高性能集成电路对于测试要求。
4	新兴 5.5G 射频前端芯片晶圆测试方案开发	研发阶段	利用 93K 和 Chroma 平台开发新兴 5.5G 射频前端芯片晶圆的测试方案，形成通用的测试软硬件方案和测试代码，并积累相应的基础测试数据和项目经验，为以后类似产品实际量产开发提供数据指导。
5	人工智能芯片可靠性验证平台(三期)	已结项	实现清洗冗余的参数，获取客户配置的参数信息解析，并按照配置好的信息，检测良率的差异值和设定的比较值，对于 Yield 中良率失效性，统一分析，实现智能化，高标准异常数据筛选。
6	车规级 SOC 芯片晶圆及成品测试方案开发	研发阶段	开发车规级 SOC 芯片的晶圆及成品测试方案，确保芯片的功能、性能和可靠性。为公司未来在汽车电子测试提供相关的技术支持和方案支持，以确保公司未来在汽车电子测试领域保持竞争力和话语权。
7	高性能 ChipLet 芯片成品测试方案开发	研发阶段	Chiplet 有利于降低设计的复杂度和设计成本，同时也有望降低芯片制造的成本，但是 Chiplet 对测试的挑战会进一步上升，例如测试流程控制以及各类高速接口测试。公司迎接 Chiplet 对测试的挑战，不断开发新的测试技术和测试方案，以确保公司未来在先进测试领域保持持续竞争力。
8	低中高全功率全封装模式老化板兼容性架构平台	已结项	构建先进的老化系统平台，建立技术优势，实现汽车电子、精密仪器测试、Burn-in 一体化。
9	恒温恒湿防尘防静电智能管理老化板仓储管理（二期）	已结项	提供一种老化炉板卡系统，可以自动计算老化炉板卡的使用信息，预测老化炉板卡的使用期限，自动预警即将失效的老化炉板卡，系统化显示每张老化炉板卡的状态、借出和返回状态等信息。

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标
10	高功率大尺寸视觉全自动翻盖机械手老化板上下料设备	已结项	一种通过为数控机床安装机械手系统，取代原来的人工操作，实现工件的自动抓取、上料、下料、装夹和加工等工序的全自动化操作。上下料机械手工作站按用途分有加工中心上下料机器人、焊接机器人、冲压上下料机器人、铸造锻造上下料机器人，主要由工业机器人、料仓系统、末端夹持系统、控制系统、安全防护系统等，通过系统集成，可以实现机床、加工单元、流水线和柔性加工单元的机加工自动化。上下料机器人工作站由数控机床、地轨、机器人、专用抓手、毛坯料仓、翻转辅助装置、一套安全护栏和一个成品料仓组成。进一步地，我司为机床定制 MDC 即机床采集与监控系统，并连入 MES。
11	成品芯片烘烤系统防呆研发	已结项	提供一种芯片测试烘烤防呆方法，解决将芯片放错烤箱造成芯片报废的问题，减少成品运行成本、保障客户的交期等。

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标
12	分布式高可用高负载自动化分片数据存储引擎	已结项	一种分布式高可用高负载自动化分片数据存储引擎，包括：系统采用分布式架构，数据被分散存储在多个节点上，以实现水平扩展和提高性能；具备故障转移、容错机制和自动恢复功能，确保系统持续可靠运行；将数据划分为多个片段（shard），每个片段可以独立处理请求，从而均衡负载并提升并发能力；系统应具备自动化的数据迁移、负载均衡、扩缩容等管理功能，减少人工干预，并保证系统稳定性；确保数据在各个节点之间的一致性，支持事务处理和强一致读写操作；提供访问控制、加密传输等安全机制，防止数据泄露和攻击风险；通过缓存技术、查询优化等手段提升系统响应速度和吞吐量；集成监控系统实时监测节点状态、负载情况，并及时报警处理异常情况；支持根据业务需求灵活扩展节点数量或增加存储容量，以适应不断增长的数据规模和访问压力。
13	车规级高精密测试参数测试方法	已结项	提供一种改进车规芯片温度敏感的测试方法，确保其在不同温度条件下的稳定性和可靠性，为车规芯片的质量控制和性能提升提供有力支持。本项目的实施将带动相关测试设备和技术的发展，促进汽车电子产业链的整体升级。
14	FT 小封装体 MTBJ 综合效率提升	已结项	改善小型封装半导体的精密放料偏移问题的辅助装置，增加产品可靠性。
15	跨平台晶圆测试数据传输分析系统	已结项	在半导体晶圆测试过程中，测试数据是至关重要的一环，故需要对数据进行传输。公司自动传输系统是提供专用的数据服务器能够自动提取测试机相应的测试数据，并能够自动对测试数据进行分类、整理、分析并能够自动根据客户需求进行数据的上传和分发，解决了客户获取数据准确性和及时性的问题。

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标
16	车规电机驱动 MCU 的晶圆测试开发解决方案	研发阶段	实现车规级电机驱动 MCU 的高效晶圆测试 ATE 解决方案开发, 满足新能源车迅猛发展所带来的对高性能电机驱动芯片的需求。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况是否合规

(一) 募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	123,717.95
截至期初累计发生额	项目投入	B1	124,314.89
	利息收入净额	B2	1,313.46
本期发生额	项目投入	C1	575.68
	利息收入净额	C2	0.78
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	124,890.57
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,314.24
应结余募集资金		E=A-D1+D2	141.62
实际结余募集资金		F	18.81
差异[注]		G=E-F	122.81

注：差异一部分系公司使用自有资金支付 30.95 万元印花税所致，另一部分系无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目和集成电路测试研发中心建设项目全部投资款项支付完成之日时的节余募集资金以及后续产生的利息共计 153.76 万元转一般户补充流动资金所致，故实际募集资金结余较应结余募集资金少 122.81 万元。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已按规定全部使用完毕，全部募集资金专户均已注销完毕。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心

技术人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司控股股东为上海蕊测半导体科技有限公司，持有公司 35,142,689 股股份，持股比例为 30.87%。2024 年度，公司控股股东持股数量未发生变化，不存在质押、冻结或减持情况。

截至 2024 年 12 月末，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员直接持股情况如下：

姓名	职务	持股情况(股)
骈文胜	董事长、总经理、核心技术人员	21,276
闻国涛	董事、副总经理、核心技术人员	17,022
路峰	董事、副总经理、核心技术人员	17,022
陈凯	董事	
祁耀亮	董事（已离任）	
于波	董事（已离任）	
林秀强	独立董事	
王怀芳	独立董事	
宋海燕	独立董事	
乔从缓	职工代表监事、监事会主席	
高晓	监事	
周歆瑶	监事	
王沛	副总经理、董事会秘书、财务总监、董事	12,766
刘琨	副总经理、核心技术人员	10,639

注:上表中与“持股情况”相关均为直接持股数量，不包括间接持股。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有的股份均不存在质押、冻结或减持情况。

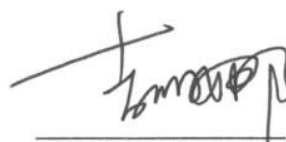
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：


牟军


吉丽娜

